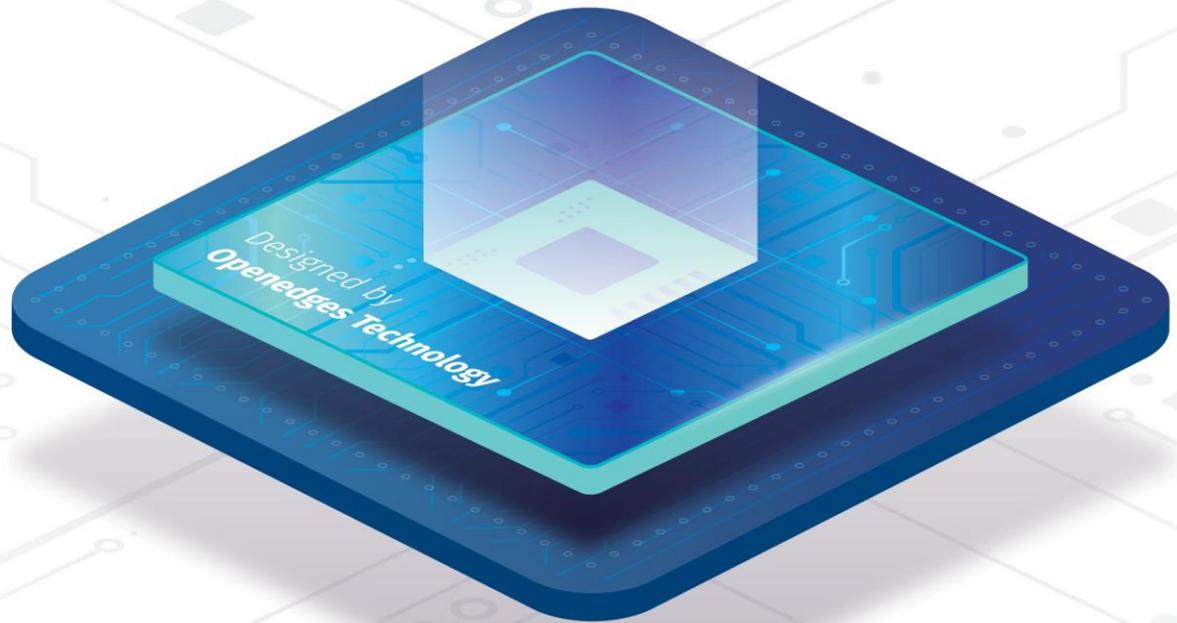


# AI for Everyone, Everywhere



# Disclaimer

본 자료는 기관투자자와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서 정보 제공을 목적으로 오픈엣지테크놀로지 주식회사 (이하 "회사")에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 받아들이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있습니다.

본 자료에 포함된 "예측정보"는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 미래 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 "예측정보"는 경영 환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며 실제 미래 실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

미래 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 시장 환경과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 시장 환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대해 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 하지 않으며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

# The Future of AI Computing

## Table of Contents

Openedges Technology  
At a Glance

Prologue

01

시스템 반도체 시장의  
구조적 성장

02

국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업,  
오픈엣지테크놀로지

03

'23년 3분기 경영실적

Appendix

# Openedges Technology at a Glance

**107%**

연매출 성장률(최근 5년)

\* 2018년~2022년



**51**

누적 라이선스 계약

2023년 3분기 기준  
(11/7일 수주 포함)



**118**

Global R&D engineers

\* 한국 최대규모



AI for Everyone, Everywhere

OPENEDGES  
Technology, Inc.

**30+**

고객사 수

\* 삼성전자, SK Hynix, Micron 등  
글로벌 Top-tier 고객 기 확보



**20+**

판매가능 IP 제품 수

\* IP 종류는 총 4개이며  
각 제품군 내 판매가능 개별 IP 제품 수



**3**

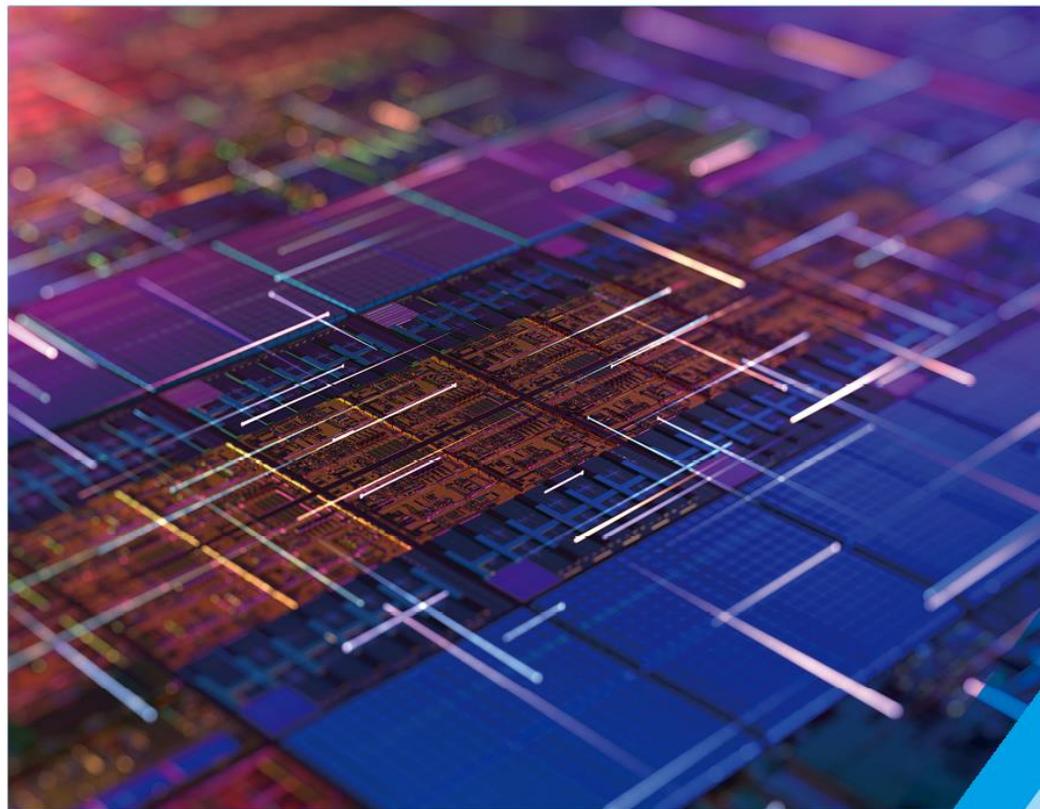
글로벌 R&D 센터

\* 한국, 미국, 캐나다 소재



# Prologue

오픈엣지테크놀로지 사업 영역



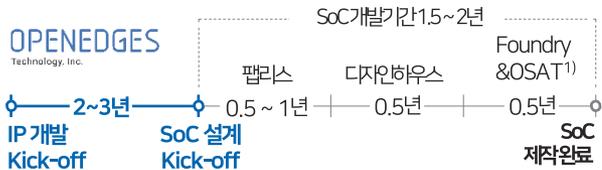
# 오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ①

**반도체 IP는 AI 반도체를 포함한 SoC (System on Chip)의 개발 기간 단축과 비용 절감 및 천억 원 이상 규모의 개발 실패의 위험을 경감시키는 높은 수준의 기술력이 요구되는 Ready-made 솔루션**



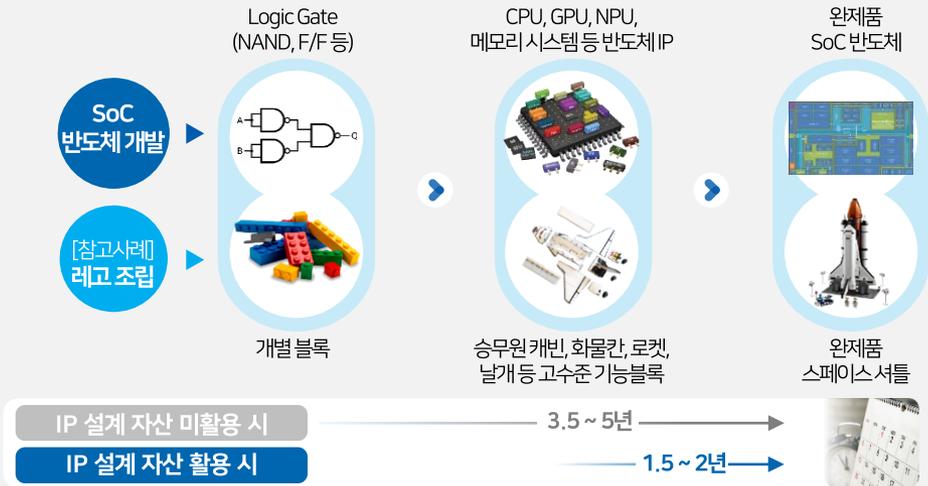
## 반도체 IP란?

CPU, GPU, NPU 등 SoC에 들어가는 사전적으로 설계/검증된 기능 블록



\* 주1) Outsourced Semiconductor Assembly and Test (패키징 등 후공정 업체)

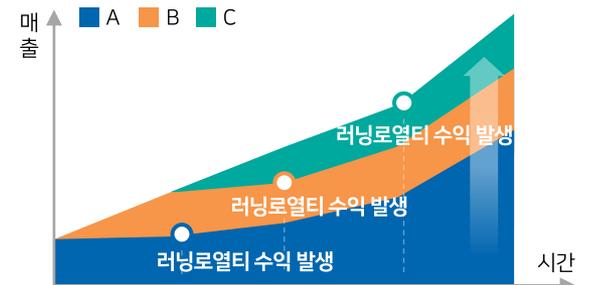
## Fabless 업체의 SoC 반도체 설계 시간 및 비용 단축



## 반도체 IP 사업의 수익구조

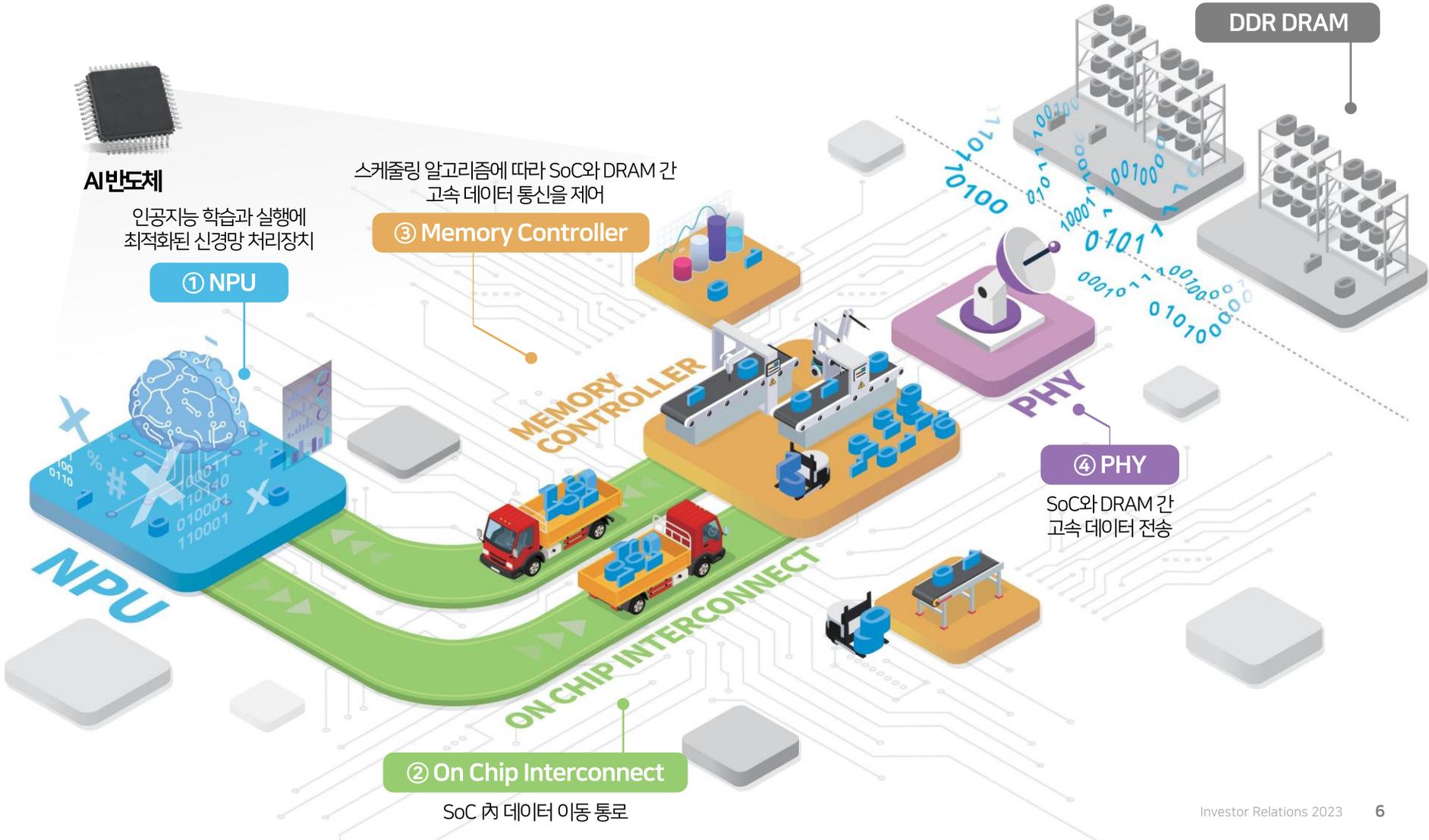


※ 반도체 IP 업계는 높은 기술장벽으로 소수 플레이어의 과점시장



# 오픈엣지테크놀로지 사업 영역 ②

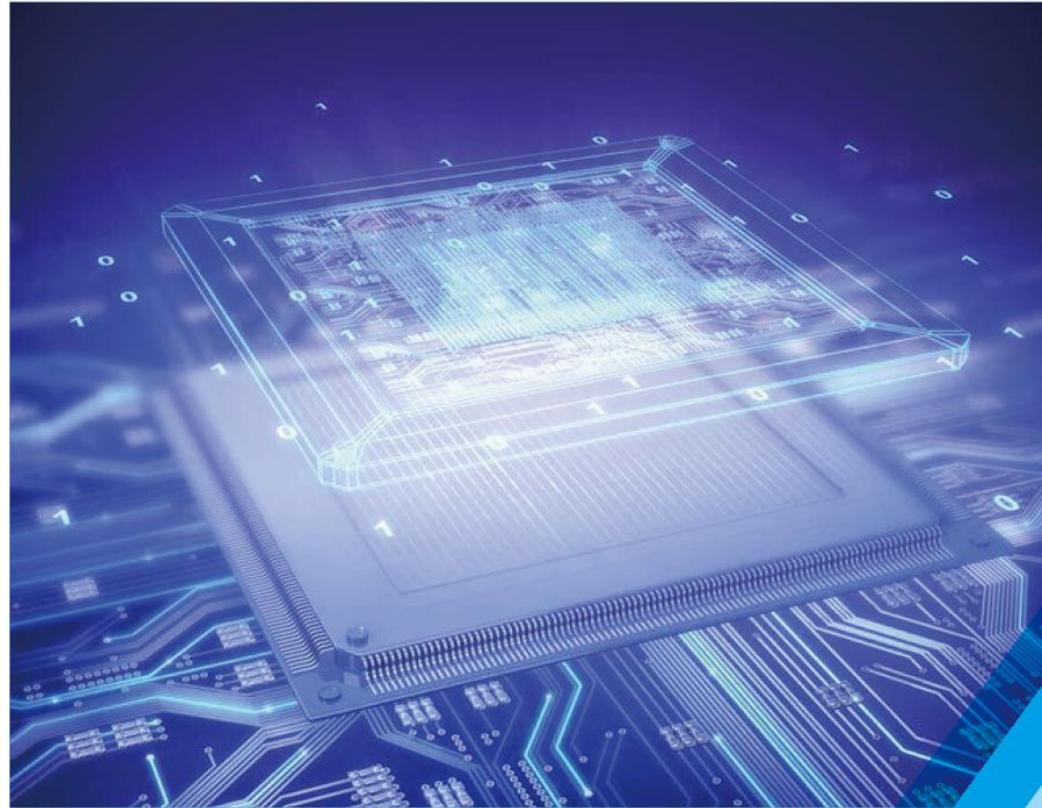
## AI 반도체의 구동 기반이 되는 통합 IP 솔루션 설계 및 제공



# 01

## 시스템 반도체 시장의 구조적 성장

- 01. AI반도체 및 IP 시장 성장
- 02. 반도체 IP 설계업체의 역할



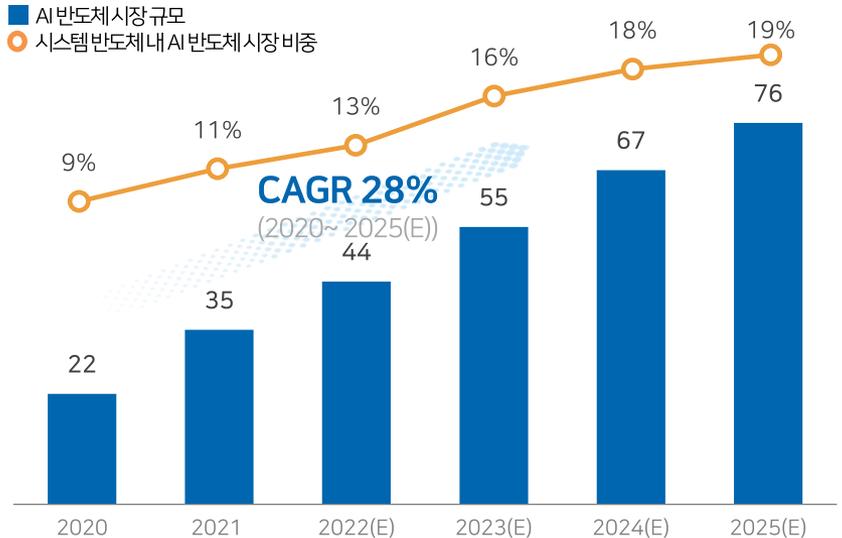
# 01 | AI 반도체 및 IP 시장 성장

## AI 반도체와 IP 시장의 견조한 성장세 지속

### 2018~2023년 글로벌 반도체 시장 전망



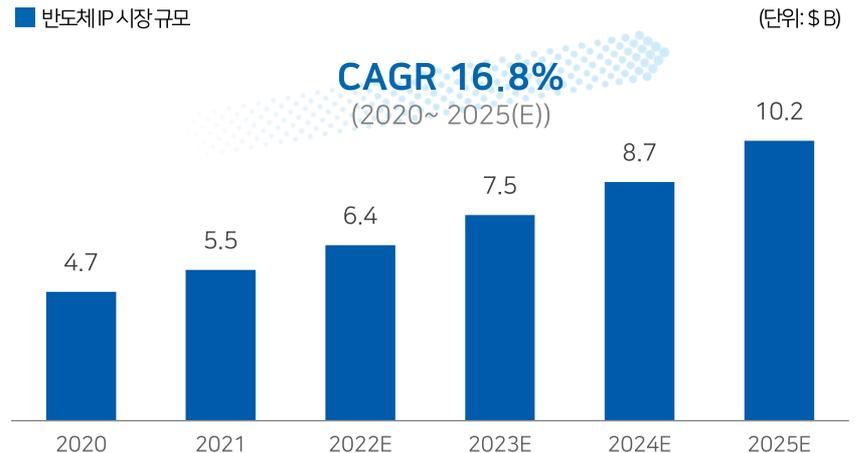
### 글로벌 AI 반도체 시장 전망 및 비중



※ Source: AI Semiconductor (Gartner, May 2022)

### 반도체 IP 시장 전망 및 경쟁 현황

업체명	2022 매출 (\$ M)	CAGR ('18 ~ '22)
arm	2,742	9%
SYNOPSYS	1,315	16%
cadence	358	14%
OPENEDGES Technology, Inc.	7.7	107%
Others		11%
Total		14%



※ Source: IPnest 2022.05월, Press Clipping

# 02 | 반도체 IP 설계 업체 역할

반도체 IP 기업은 팹리스 및 디자인하우스가 필요로 하는 기능 블록을 선제적 개발 및 공급

## 시스템반도체 Ecosystem

	반도체 IP 설계 업체	팹리스 (Fabless)	디자인 하우스	파운드리 (Foundry)	(O)SAT <sup>1)</sup>
주요 업무	반도체 주요 기능블록 설계	반도체 칩 설계 (Frontend 설계 담당)	반도체 칩 설계 외주 (Backend 설계 담당)	반도체 칩 제조 (Wafer 공정 업체)	후공정 담당 (패키징 업무)
Player 수	20개 기업 내외 과점 시장	3,000개 이상	N/A <sup>2)</sup>	Top 10 M/S 97% 차지	Top 25 M/S 50% 차지
규모	\$6B <small>*기업당 시장피어 최대 규모</small>	\$120B	N/A	\$82B	\$42B
주요 업체	   	    	  	   	   

## IP시장의 과점화 이유

검증된 IP에 대한 니즈 증가



진입장벽이 높아 검증된 IP 업체의 희소 가치 부각



고도의 기술 인력 필요

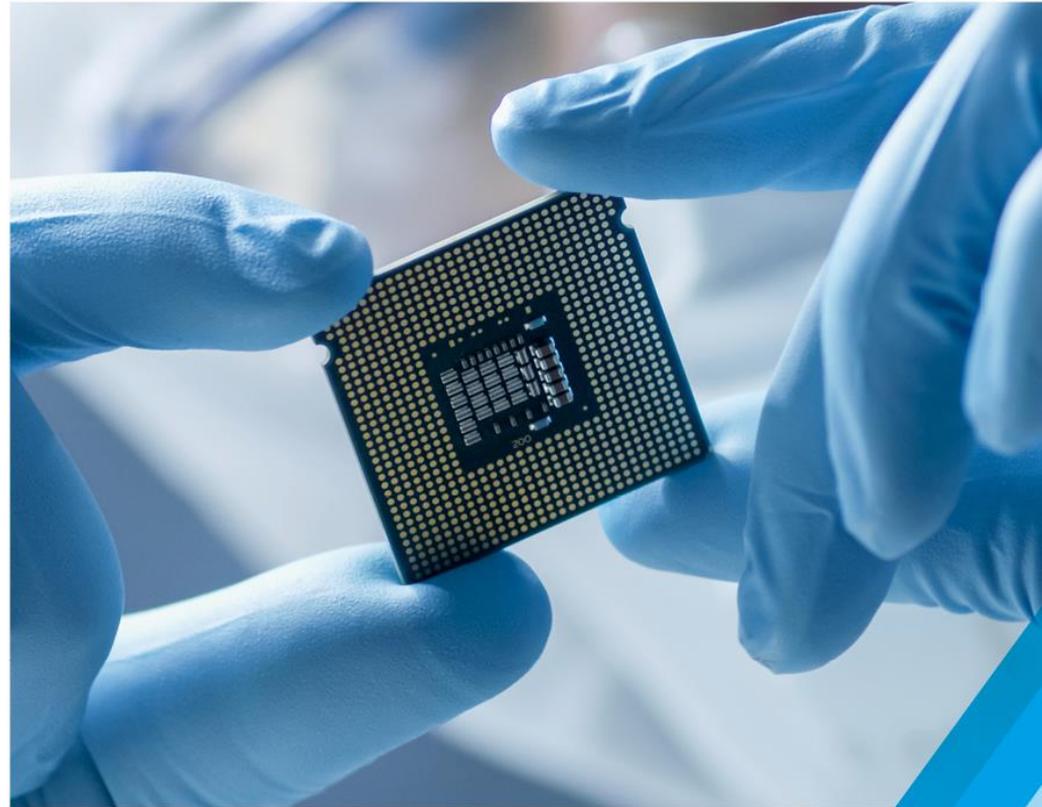
최소 3년 이상의 R&D 투자 필요

\* 주1) (Outsourced) Semiconductor Assembly and Test: 반도체 패키징 조립 및 테스트 업체로 웨이퍼 공정 이후 후공정 담당  
 주2) Design House 시장은 공신력 있는 시장 규모 데이터 부재

# 02

## 국가대표 AI 반도체 IP 설계 기업, 오픈엣지테크놀로지

- 01. 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary
- 02. 글로벌 최고 수준의 Manpower
- 03. 업계 최고 수준의 기술경쟁력
- 04. 검증된 글로벌 Track Record
- 05. 글로벌 기업과의 전략적 Partnership



# 01 | 오픈엣지테크놀로지 핵심경쟁력 Summary

오픈엣지는 AI 반도체 IP 시장의 글로벌 리더가 되기 위한  
**핵심 성공요인을 확보**

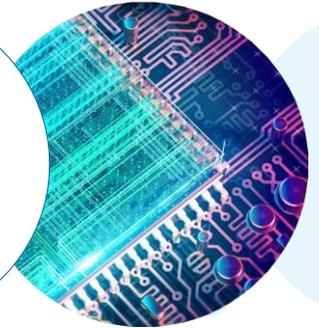
01



글로벌 최고수준의  
Manpower



02



업계 최고수준의  
기술경쟁력



03



검증된  
글로벌 Track Record



04



글로벌 기업과의  
전략적 Partnership



# 02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower - Global Presence

## OPENEDGES Technology, Inc.



**Openedges Square Corporation** (USA)

- 주요 역할: Cache Coherence NOC IP R&D
- 설립 시기: '23년 8월

**Openedges Technology Corporation** (USA)

- 주요 역할: 북미 지역 영업 거점
- 설립 시기: '21년 7월

**The Six Semiconductor** (Canada)

- 주요 역할: DDR PHY IP R&D
- 설립 시기: '18년 6월('19년 12월 M&A)



**( 미국, 캐나다 해외 법인 외 글로벌 거점 확대 )**

# 02 | 글로벌 최고 수준의 Manpower

## 국내 최대 규모 및 Global 경쟁력을 갖춘 R&D Engineer들이 확보된 반도체 IP 설계기업



### 전사 R&D 인력현황

총인원(140명)의  
**84%**

**118명**  
R&D 인원

R&D 인력 중  
석박사(60명) 비중  
**51%**



### 지역별 현황




**이성현**  
대표이사/CEO

**SAMSUNG** | **SAMSUNG** UNIVERSITY ADVANCED INSTITUTE OF TECHNOLOGY

서울대학교 전기·컴퓨터공학박사 수료  
'17~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) 대표이사  
'08~'15 삼성전자 수석연구원 (Exynos 개발)  
'07~'08 삼성종합기술원



**최정환**  
NPU 팀장

**SK hynix** | **SAMSUNG**

Purdue대학교 전기 및 컴퓨터공학박사  
'18~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) NPU 팀장  
'15~'18 SK 하이닉스 수석연구원  
'09~'14 삼성전자 Architecture Lab 파트장



**Richard Fung**  
TSS/CEO

**AMD** | **PERASO**

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사  
'18~ 現 The Six Semiconductor CEO  
'12~'18 Peraso Technologies Silicon Director 등  
'00~'11 AMD PHY Analog Design Manager



**Moez Cherif**

**ARTERIS IP** | **MAGMA** | **SYNOPSYS**

INPG Univ. 컴퓨터과학 박사  
'21~ 現 오픈엠티테크놀로지 미국법인 S/W 그룹장  
'18~'21 Arteris IP Principal S/W Architect  
'95~'17 Synopsys, Magma Design Automation 등



**황인조**  
R&D 센터장/CTO/  
Co-founder

Codeholics/ | **대우전자** | **Chips&Media**

서울대학교 전기공학 석사  
'17~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) CTO  
'10~'15 코드홀릭스 CTO  
'00~'10 대우전자, 칩스앤미디어



**문상훈**  
Memory controller  
팀장

**SK hynix** | **SAMSUNG**

서울대학교 컴퓨터공학 석사  
'18~ 現 오픈엠티테크놀로지(주) MC 팀장  
'17~'18 SK 하이닉스 Memory System 연구소 파트장  
'00~'16 삼성전자 AP 개발팀 파트장



**Ricky Lau**  
TSS/CTO

**AMD** | **SYNOPSYS**

Univ. of Toronto 전기전자공학 석사  
'18~ 現 The Six Semiconductor CTO  
'14~'18 Synopsys PHY Digital Design Engineer  
'03~'14 AMD PHY Analog Design Engineer 등



**Roger Jennings**  
OTC/VP  
of Engineering

**ARTERIS IP** | **AMD** | **intel**

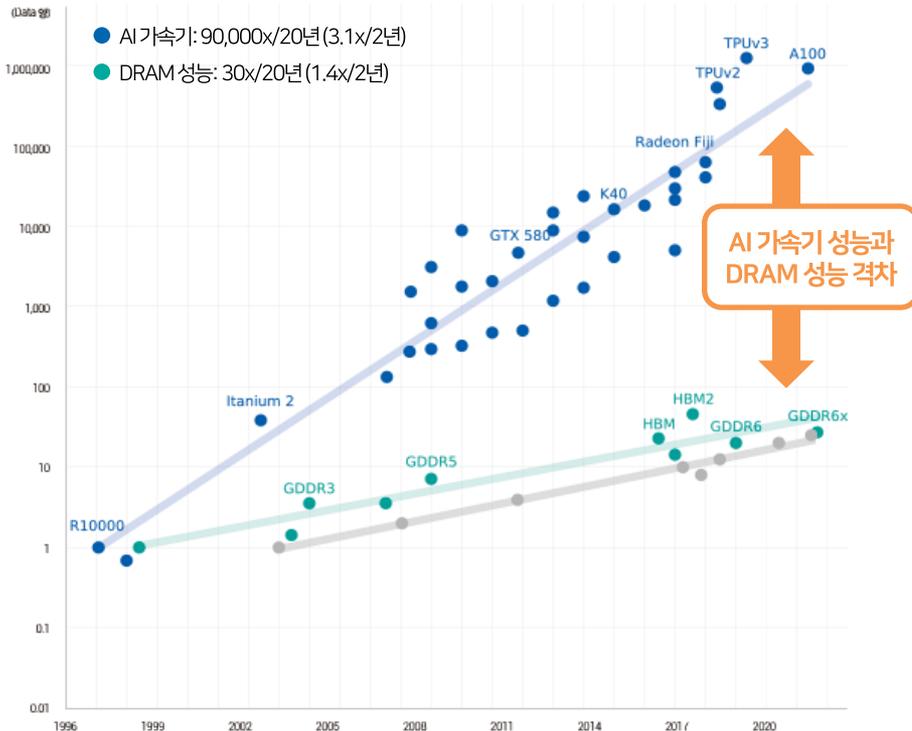
Univ. of Memphis 전자전기공학 석사  
'22~ 現 오픈엠티테크놀로지 미국법인 VP of Engineering  
'20~'22 Arteris IP Senior Director of Engineering  
'02~'20 Intel, Juniper Networks, AMD 등

※ 2023년 3분기말 기준

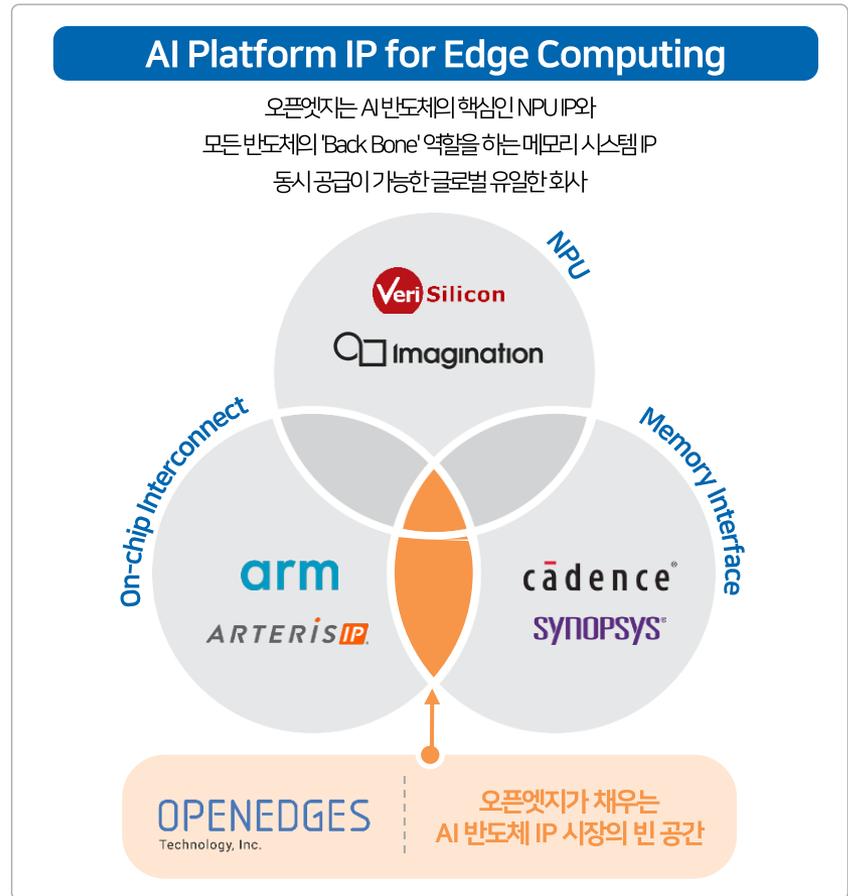
# 03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ①

**AI 반도체는 'Data Intensive Computing'**  
 → 자원이 제약된 엣지 환경 아래 NPU와 메모리 시스템 최적화가 필수  
 오픈엣지는 글로벌 유일 AI 반도체 통합 IP 솔루션 공급 가능 업체

AI 가속기 기술 발전에 따라 Data 처리 요구량과 DRAM에서 제공하는 성능 간 격차 확대

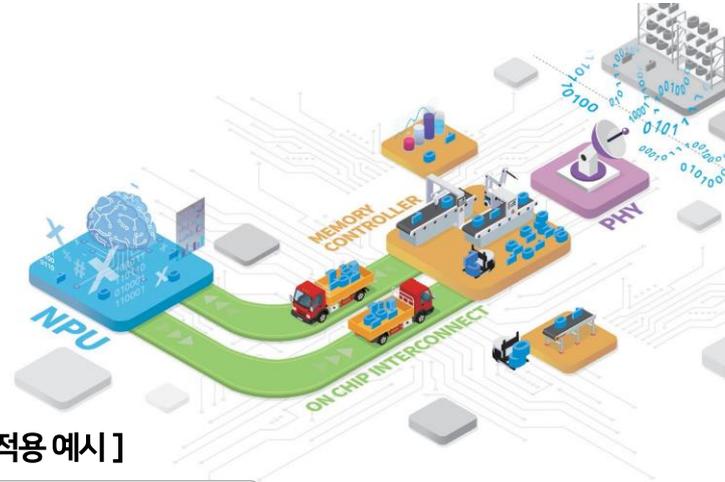


※ 출처: AI And Memory Wall By Riselab

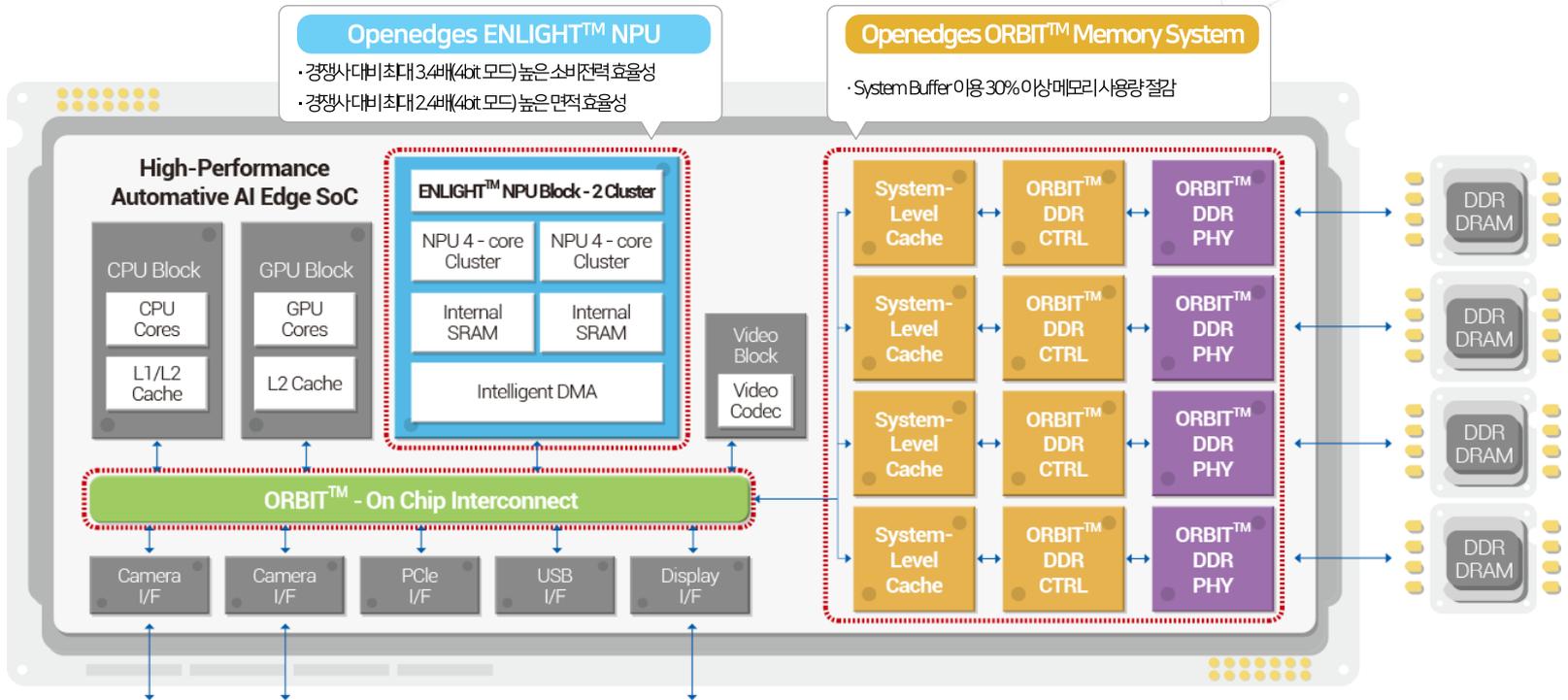


# 03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ②

## 오픈엠텔지는 경쟁사 대비 높은 효율성을 (소비 전력 / 면적 / 메모리) 확보하여 AI 반도체 IP 기술을 선도



[ 당사 통합 IP솔루션의 자율주행 차량용 AI 반도체 적용 예시 ]



## 03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ③

### 최선단 공정 중심 기술개발을 통한 시장선도 및 경쟁력 강화

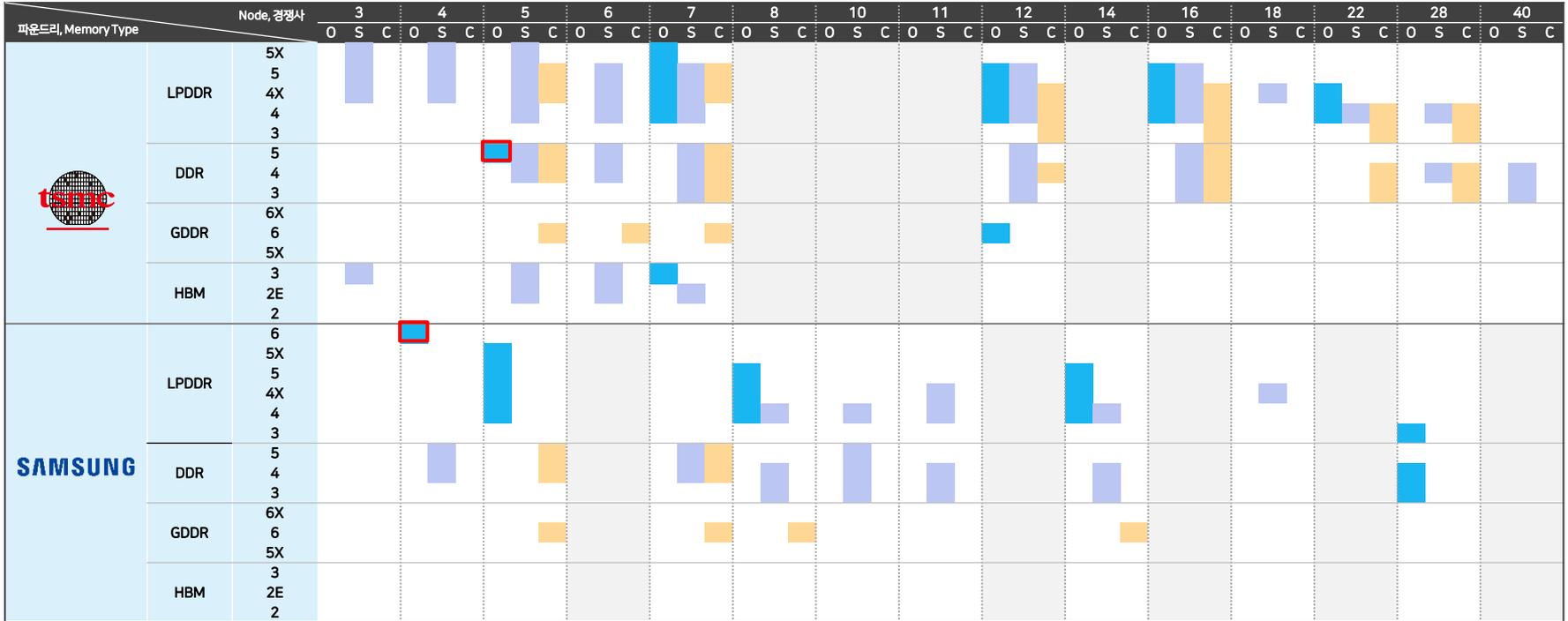
구분	IP	Description	개발현황	Remark
AI Platform IP Solution for Edge Computing	ENLIGHT™ (Neural Processing Unit)	ENLIGHT™-L(1st gen. a.k.a v1.0)	Now	경량 IoT 응용제품(키워드 인식, 보안카메라 급 응용)
		ENLIGHT™-R(2nd gen. a.k.a v2.0)	Now	중급 이상 IoT 응용제품(자율주행 보조 급 응용)
		ENLIGHT™-P(3rd gen. a.k.a v3.0)	개발 중('24.H1 출시)	차량용 고성능 응용제품(레벨3급 이상 자율주행 차량 응용)
		ENLIGHT™-X(4th gen. a.k.a v4.0)	개발 예정	차량용 고성능 응용제품(레벨4급 이상 자율주행 차량 응용, multi-die 버전)
Total Memory System Solution IP (ORBIT™)	OMC™ (DDR Memory Controller)	DDR4/3, LPDDR4X/4/3	Now	현재 Mainstream 기술
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	차세대 Mainstream 기술
		HBM3	Now	서버 및 초고성능 제품 향
		DDR5	Now	차세대 Mainstream 기술
		GDDR6	Now	고성능 AI 제품 향
		GDDR7	개발예정	차세대 고성능 AI 제품 향
		LPDDR6	개발예정('24년 착수 예정)	차세대 Mainstream 기술
	OPHY™ (DDR PHY)	LPDDR4X/4	Now	TSMC 22nm 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	TSMC 16nm 공정용
		LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4	Now	TSMC 12nm 공정용
		GDDR6	Now	TSMC 12nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	TSMC 6/7nm 공정용
		HBM3	Now	TSMC 6/7nm 공정용
		DDR5	개발예정('24년 착수 예정)	TSMC 5nm 공정용
		LPDDR6	개발 예정	-
		LPDDR3, DDR4/3	Now	Samsung 28nm 공정용
		LPDDR4X/4, LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 14nm 공정용
		LPDDR5/4X/4	Now	Samsung 8nm 공정용
		LPDDR5X/5/4X/4	Now	Samsung 5nm 공정용
		LPDDR6	개발예정('24년 착수 예정)	Samsung 4nm 이하 공정용
	GDDR7	개발 예정	-	
	OIC™ (On-Chip-Interconnect)	OIC™	Now	Non-Cache-Coherent NoC
		OIC™-AI	개발 중	Cache-Coherent NoC

# 03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ④

글로벌 주요 경쟁사가 cover하지 못하는 영역에서 역량을 집중, 시장 점유율 확대

## DDR PHY IP 경쟁 현황

Openedges    Synopsys    Cadence



□ 개발예정 IP

오픈엠티테크놀로지  
시장 점유율  
확대 전략

- ✓ Synopsys와 Cadence는 TSMC 5나노 이하 선단 공정에 집중
- ✓ 특히 SSF 5nm LPDDR5X/5 용 PHY IP는 주요 IP Vendor들 중 유일하게 개발하여 고객에게 제공 중
- ✓ 오픈엠티테크놀로지는 Legacy 공정에서 TSMC, SSF 5nm까지 다양한 IP 개발을 통한 PHY IP Line up 확대 진행
- ✓ 경쟁사 대비 50% 이하의 면적으로 구현한 test chip에서의 성능 확보를 통한 제품 경쟁력 제고

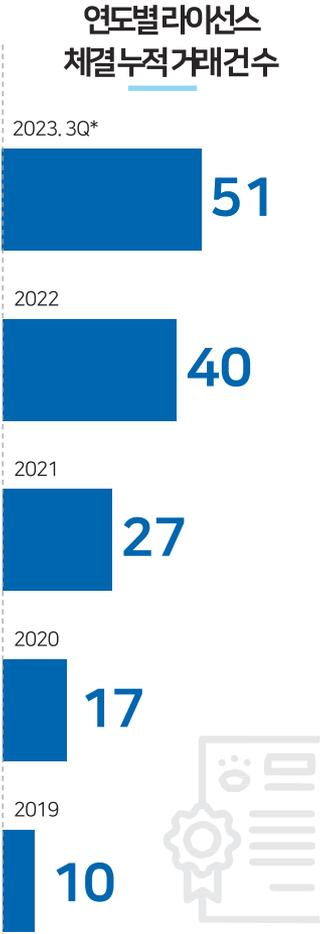
# 03 | 업계 최고 수준의 기술경쟁력 ⑤

## 최선단 공정의 지속 개발을 통해, AI 반도체 통합 IP 솔루션의 선점 효과를 극대화할 예정

예상 출시 일정		2021		2022		2023		2024		2025	
		1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H	1H	2H
ENLIGHT™ Neural Processing Unit		NPU v1.0		NPU v2.0				NPU v3.0 Autonomous Driving		NPU 4.0 Autonomous Driving	
		[성능] 0.25~2 TOPS [타겟제품] 경량 IoT 응용제품 (키워드 인식, 보안 카메라 응용)		[성능] 2~16 TOPS [타겟제품] 중급 이상 IoT 응용제품 (자율주행 보조급 응용)		[성능] 16~250 TOPS [타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 3급 이상 자율주행 차량 응용)		[성능] 250~1,000 TOPS [타겟제품] 차량용 고성능 응용제품 (Level 4급 이상 자율주행 차량 응용 Multi-Die 버전)			
OIC™ On-Chip Interconnect	Non-Cache Coherent NOC	OIC v.1.X						OIC v.2.0			
	Cache Coherent NOC									OIC-AI	
OMCT™ Memory Controller		GDDR6	LP5X/5 /4X/4		HBM3	DDR5					
OPHY™ DDR PHY	SAMSUNG		LP4/4X/5 (14nm)				LP5X/5/4X (5nm)		LP6 (4nm)		
	tsmc			LP4/4X/5 GDDR6 (12nm)	LP4/4X/5 (22nm)	HBM3 LP4X/5/5X (7nm)			DDR5 (5nm)		
OUC(미정) Controller Die to Die (Chiplet Controller)									UCle v1.1 Controller (AXI streaming)		UCle v1.1 Controller (Full spec.)
OPHY™ PHY Die to Die (Chiplet)	SAMSUNG									OPHY-D2D (5/8nm)	
	tsmc									OPHY-D2D (6nm)	

# 04 | 검증된 글로벌 Track Record

다양한 산업의 필수 솔루션으로 가치를 인정받아 글로벌 Track Record 확대 중



\* 11/7 공시된 계약 포함

# 05 | 글로벌 기업과의 전략적 Partnership

## 안정적 IP 수요 확보 + 최신 기술 및 시장 트렌드에 대한 선도적 대응

### 타 IP 기업과의 Partnership 강화

- 글로벌 A 社
- 글로벌 C 社
- 글로벌 M 社

통합IP 제공을 위한 전략적 Partnership 협의 중

- Qualitas SEMICONDUCTOR
- HANA MICRON

Chiplet 정부 과제 수행

### Top tier 고객 확보를 통한 Reference 확보

SAMSUNG SK hynix Micron

글로벌 I 社 AISIN

alchip MONTAGE Technology JLQ TECHNOLOGY

### 파운드리 협력관계 강화

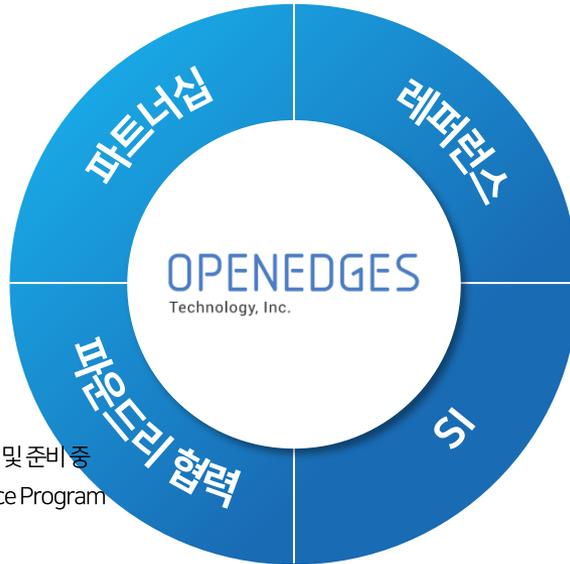


- 당사 PHY IP 라이선스 2개사가 설계 완료 후 TSMC에서 양산 진행 및 준비 중
- 양산 실적 확보 시 TSMC IP Alliance Program 정식 파트너로 편입될 예정



- 2018년 SAFE\* IP 파트너 선정
- 메모리 인터페이스 분야 IP 협력 확대 중

\*주1) SAFE (Samsung Advanced Foundry Ecosystem)



### SI와 장기적인 협력기회 모색

HYUNDAI 계열사

- 4i2dot: 460억 규모 정부 자율주행 과제 공동수행
- bos SEMICONDUCTOR: IP 라이선스 계약

SK 계열사

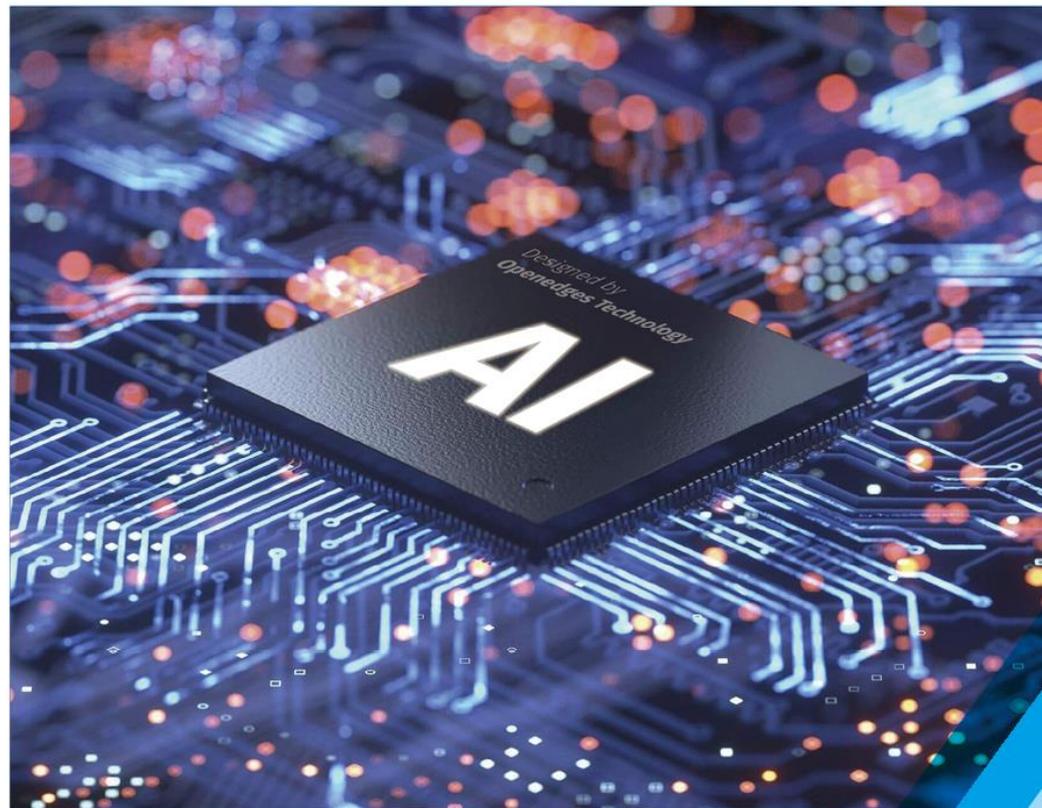
- SAPEON: IP 국책과제 수행

OPENEDGES Technology, Inc.

# 03

## '23년 3분기 경영실적

01. 매출
02. 영업이익
03. 수주현황

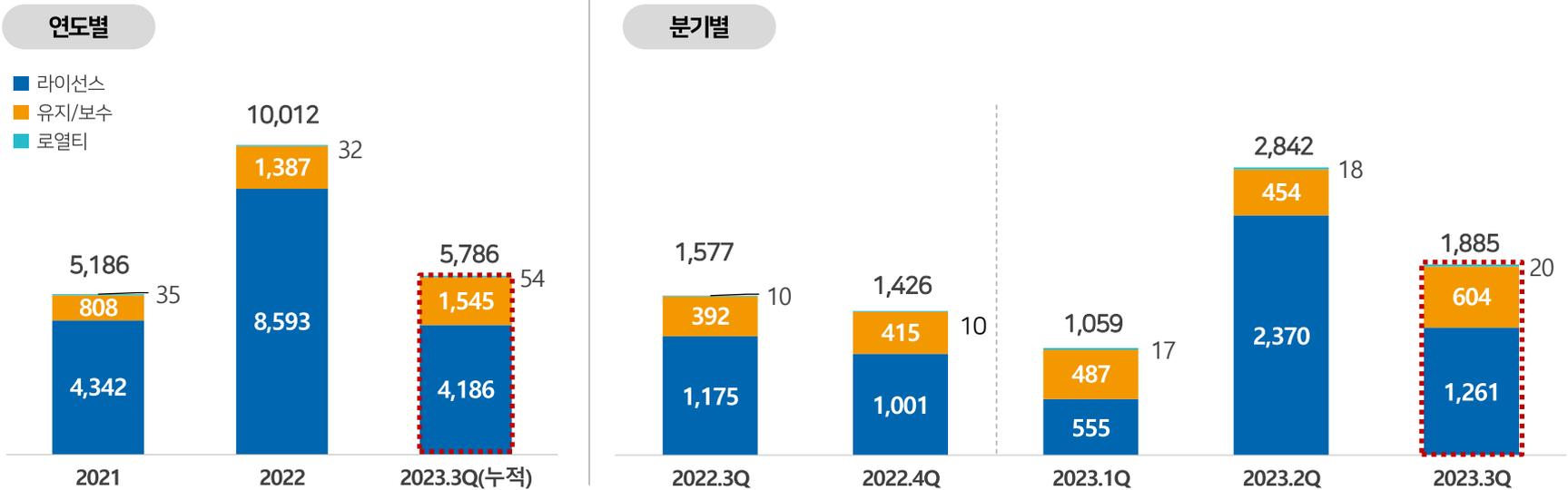


# 01 | 매출

당초 예상 대비 협의 중인 계약 체결 지연으로 매출 일정도 지연 중이나, '23년 하반기부터 활발히 수주 확보되고 있어, 향후 지속적인 매출성장 예상

## 매출 현황

(단위: 백만원)



### 매출 변동요인

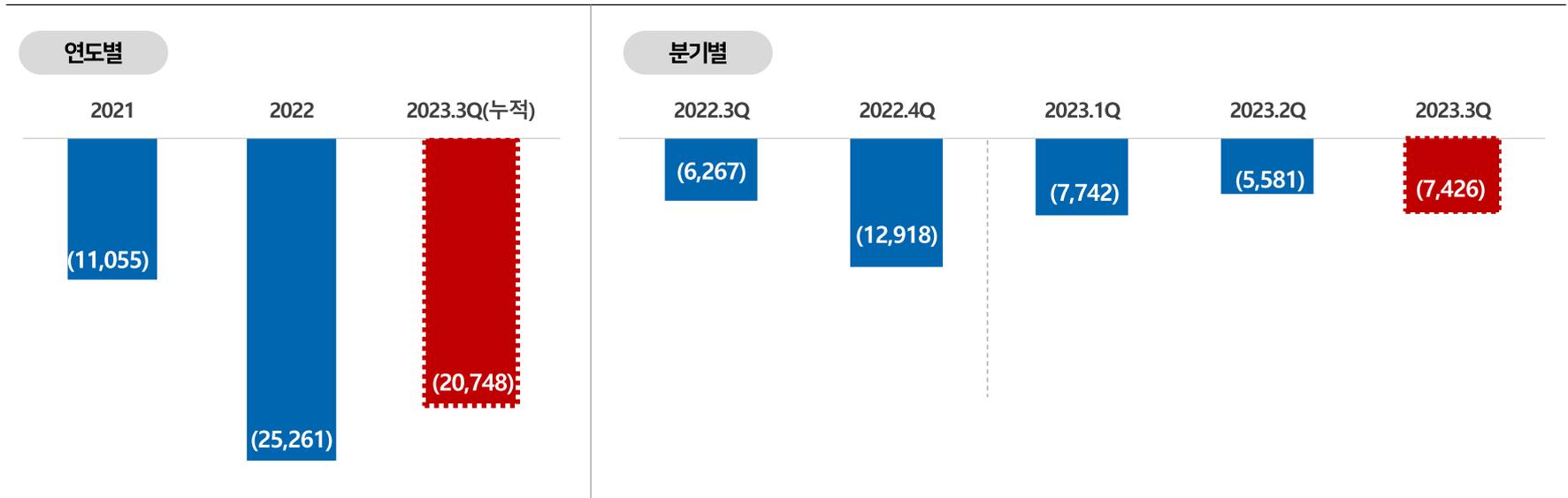
- ✓ 라이선스 : 상반기 계약 지연 영향으로 3분기 다소 감소하였으나, 하반기 증가된 IP 계약 영향으로 4분기부터 정상화 예상됨
- ✓ 유지보수 : 기 제공된 IP 계약 중 총 16건의 프로젝트에서 매출 발생 중
- ✓ 로열티 : 설립 초기 라이선스 계약에서 발생 중으로 전체 매출의 1% 수준이나, 고객사 양산 증가 시 확대될 것으로 기대

# 02 | 영업이익

향후 매출 성장에 크게 기여할 것으로 기대되는 차세대 NPU 및 선단공정 관련 IP 개발을 위한 R&D 투자 지속 중

## 8 영업이익 현황

(단위: 백만원)



### 영업이익 변동요인

- ✓ 분기별 비용은 85~90억 수준에서 유지 중
  - ✓ 비용 중 대부분은 R&D 비용으로 현재 개발중인 NPU v3, LPDDR5X/DDR5 PHY IP, OIC v2 등과 관련된 비용임
  - ✓ 자회사인 오픈엣지스퀘어는 3분기말 기준 연결자회사로 편입 중이나, 4분기부터는 지분법으로 전환되어 영업비용에서 제외될 예정
- \*'23.11월 VC 2곳으로부터 현금출자 180억(지분율 50%) 유치

## 03 | 수주현황

상반기 악화된 대내외 경영 여건에 따른 라이선스 계약체결 지연으로 매출 성장세가 둔화되었으나, 점차 개선 중인 수주 여건을 기반으로 4분기부터는 매출 성장 본격화 예상

### ● 재무 현황 및 수주 잔고

(단위: 백만원)

구분	분기				
	23.3Q	23.2Q	QoQ(%)	22.3Q	YoY(%)
매출액	1,885	2,842	-33.7%	1,577	19.5%
영업이익 (손실)	(7,426)	(5,581)	N/A	(6,267)	N/A
당기순이익 (손실)	(7,310)	(5,557)	N/A	(6,178)	N/A

### '23.9월말 현재 수주 상황

(단위: 수/\$M)	'22년 연간 수주 ('22.1~4Q)	과거 1년 누적 수주 ('22.4~'23.3Q)	'23년 누적 수주 ('23.~3Q)
건수	13	14	11
금액	\$7.5M	\$16.8M	\$15.0M

\* 본 수주현황은 '23년 11월 7일에 공시된 수주가 포함된 숫자입니다.

### ● 실적 변동 요인 및 전망

#### '23.3분기

#### 상반기 체결된 일부 계약에 대해 IP 제공 완료하며 매출 발생

- 상반기 체결된 계약 중 일부 IP 제공 완료되며 3분기 매출로 확정됨  
→ 올해 상반기에 계약체결이 지연되며, 매출시점이 1~2분기 늦어짐
- 비용은 크게 증가하지 않고, R&D 비용이 대부분  
→ R&D 비용은 당분간 현 수준 유지될 것으로 보이며, 매출이 R&D 비용을 커버할 경우 턴어라운드 가능한 상황

#### '23.4분기

#### 기 확보된 수주 계약을 기반으로 분기 Break-even 달성 도전

- 기 확보된 수주 중 4분기 중 다수 IP 산출물 고객사 향 전달 및 매출 인식 예상
- 내년 상반기 확보될 수주에 대해서도 고객사와 활발히 협상 중  
→ 최근 확보된 IP 제품(SF5nm, TSMC 6/7nm)들에 대한 고객의 문의 지속  
→ '24년 매출 증대를 위한 NPU v3, TSMC DDR5 PHY IP, TSMC IP Alliance 관련 개발 및 신청 준비도 순조롭게 진행 중

# 03

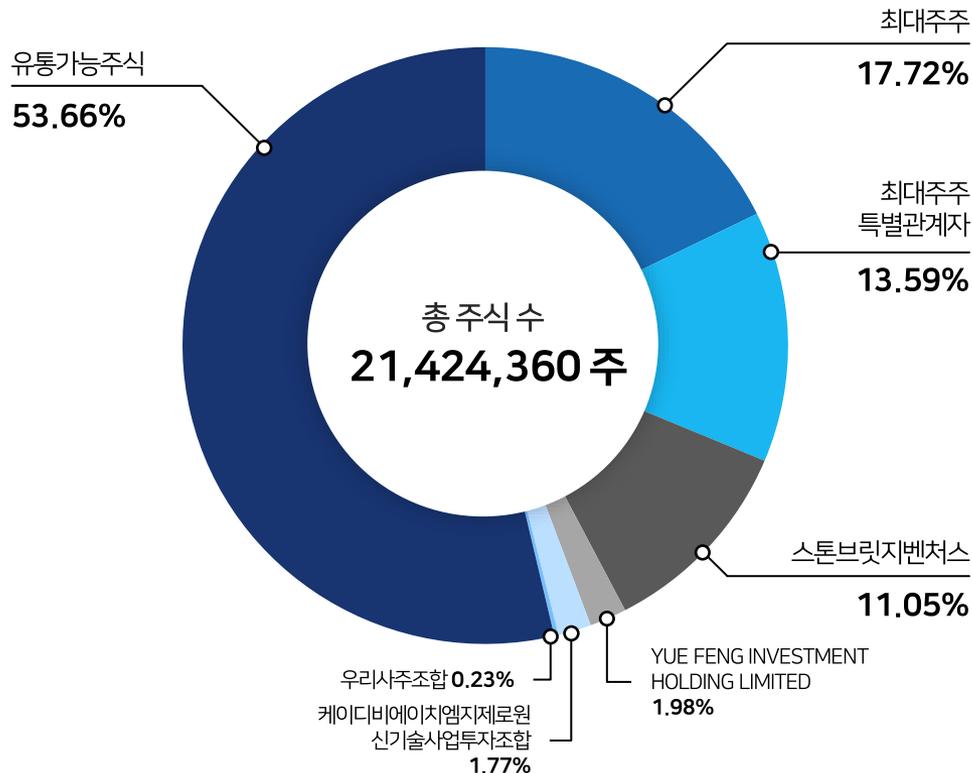
## Appendix

- 01. 주주구성
- 02. 오픈엣지스퀘어
- 03. 요약재무제표



## 최대주주(특수관계자포함) 지분율은 31.31%로 안정적인 지분 확보를 통한 경영권 확보

### Shareholders



주주명	종류	주식수	주식수(%)
최대주주(이성현 대표이사)	보통주	3,796,314	17.72%
최대주주특별관계자	보통주	2,911,543	13.59%
스톤브릿지벤처스	보통주	2,368,050	11.05%
YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED	보통주	425,000	1.98%
케이디비에이치엠지제로원 신기술사업투자조합	보통주	378,750	1.77%
우리사주조합	보통주	48,599	0.23%
유통주식수	보통주	11,496,104	53.66%
<b>Total</b>		<b>21,424,360</b>	<b>100.00%</b>

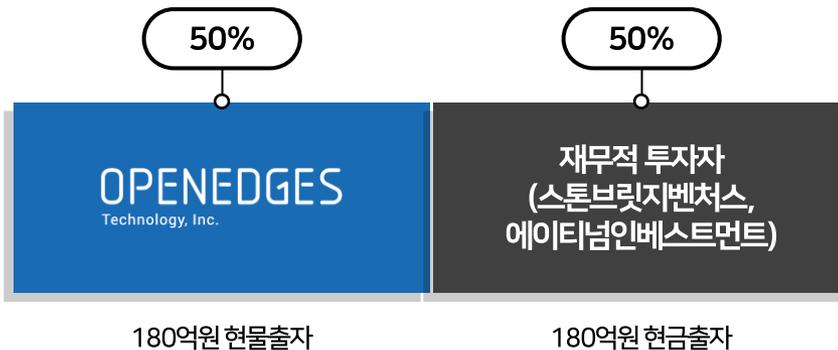
※ As of Sep. 30, 2023

## 02 | 오픈엣지 스퀘어 (1) - 개요

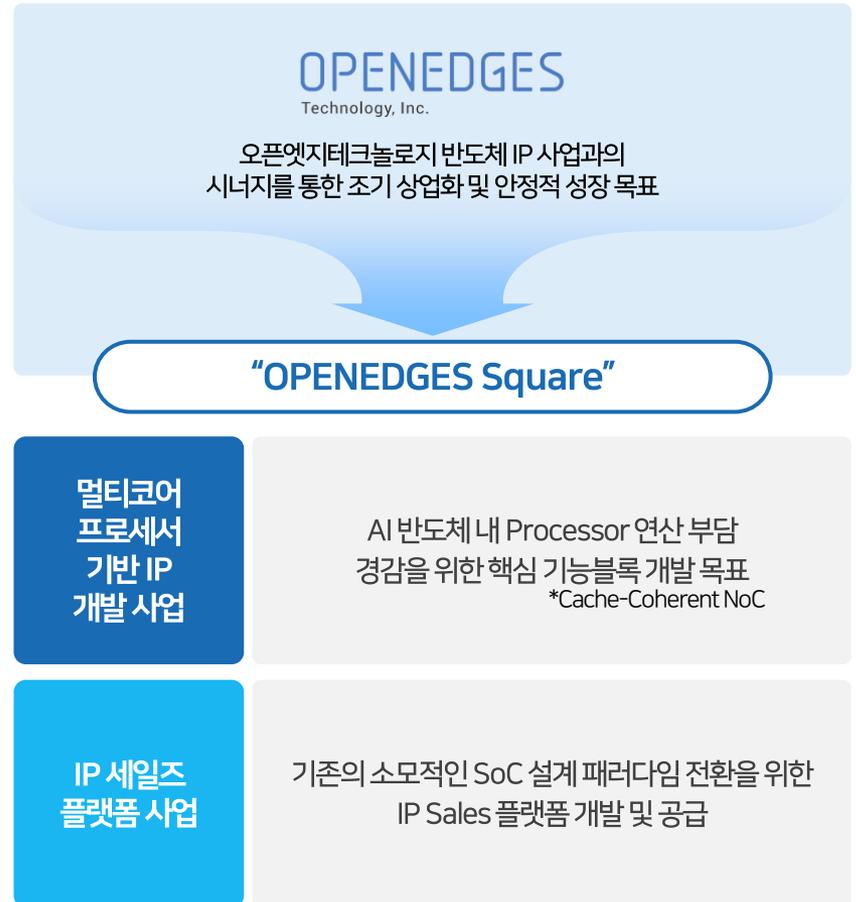
### 회사개요

회사명	OPENEDGES Square
대표이사	이성현 대표
설립일	2023년 8월
자본금	360억원(오픈엣지 180억원 현물, 재무적투자자 180억원 현금)
임직원수	7명(2023.11.1일 기준)
사업장	본점: 서울시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 10층
주요 사항	오픈엣지 HQ가 재무적투자자 지분의 35%에 대한 콜옵션 보유

### 주주현황



### 사업 현황

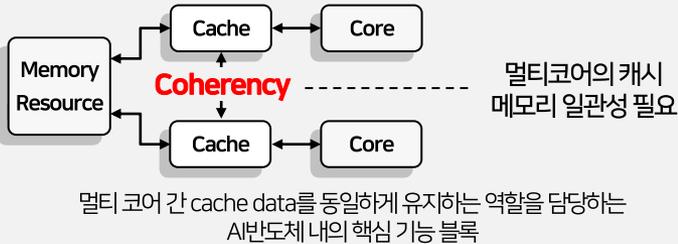


# 02 | 오픈엣지 스퀘어 (2) - 주요 비즈니스

## 멀티코어 프로세서 기반 IP 개발 사업

### Cache-Coherent NoC(CC NoC) 필요성

반도체 설계가 복잡해지며 각 프로세서들의 데이터 전송 불일치로 연산 오류 발생



현재

## IP 개발 및 성공 요인 | 연산 오류 방지를 위한 IP 개발



멀티코어 Chip



반도체 IP 개발

OPENEDGES  
Technology, Inc.

### 기술 성공 DNA 보유

- AI반도체 내 핵심 IP 4종 상업화 성공 레코드 보유
- 오픈엣지 개발 성공한 NCC NoC와 높은 기술 연관성

### 구축된 판매채널로 확보된 시장 진출

- 국내 sales 인력 외 해외(미국) Sales Agent 9곳 운영 중
- 기존 IP와 연계로 토탈 솔루션 공급 가능

향후

## IP 세일즈 플랫폼 사업

### 소모적인 IP 라이선싱 과정으로 인한 IP 세일즈 플랫폼의 필요성



### 반도체 IP 세일즈 플랫폼 오픈

OPENEDGES  
Technology, Inc.

- 플랫폼 이용료 발생
- 수수료액 일정 % 커미션 취득

수수료 정보 확인

영업 기회 확보

수요와 공급을 효율적으로 연결



다양한 IP 비교 분석 가능  
→ 칩 설계 초기 시간과 비용 절감



고객사 Pool 확대  
평가 리스스 경감 가능

## Web 기반 SoC 설계 플랫폼 사업 성공 요인

오픈엣지가 개발한 Memory System IP를 플랫폼 설계 시 적극적으로 활용 가능

오픈엣지 기존 고객사를 대상으로 효과적인 시장 진출 가능

오픈엣지와 Shared Service 계약으로 효율적인 사업 운영 가능

## 03 | 요약 재무제표

## 요약 재무상태표

(단위: 백만원)

	3Q23	2022	2021	2020
유동자산	30,473	44,304	29,020	6,216
비유동자산	12,402	9,552	7,077	4,075
<b>자산총계</b>	<b>42,875</b>	<b>53,855</b>	<b>36,097</b>	<b>10,291</b>
유동부채	24,507	18,318	9,171	5,477
비유동부채	3,472	3,288	6,374	31,551
<b>부채총계</b>	<b>27,979</b>	<b>21,606</b>	<b>15,545</b>	<b>37,028</b>
자본금	2,142	2,116	1,653	15
자본잉여금	97,909	96,376	58,927	-
기타자본항목	3,612	2,026	3,007	1,697
이익잉여금	-88,767	-68,269	-43,035	-28,449
<b>자본총계</b>	<b>14,896</b>	<b>32,249</b>	<b>20,553</b>	<b>-26,737</b>

※ 연결 재무제표 기준

## 요약 손익계산서

(단위: 백만원)

	3Q23	2Q23	증감	증감(%)
<b>영업수익</b>	<b>1,885</b>	<b>2,842</b>	-957	-33.7
영업비용	9,311	8,422	889	10.6
<b>영업이익</b>	<b>-7,426</b>	<b>-5,581</b>	-1,845	N/A
금융수익	411	319	92	-23.2
금융비용	313	301	12	-9.3
기타수익	12	10	2	-75.8
기타비용	0	7	-7	-65.6
<b>세전이익</b>	<b>-7,317</b>	<b>-5,559</b>	-1,758	N/A
법인세비용	-7	-2	-5	N/A
<b>당기순이익</b>	<b>-7,310</b>	<b>-5,557</b>	-1,753	N/A

※ 연결 재무제표 기준